



電材ジャーナル

第591号(平成18年8月~10月)

目次

巻頭言「工業会の事業支援活動」.....	早崎 俊克.....	1
「Insulation 2006」技術セミナー開催案内.....	技術部会.....	2
第3回役立つマーケットセミナーアンケート集計結果	業務部会.....	4
IEC 国際会議報告書	山野 芳昭.....	6
マーケットレポート「FPD 市場の拡大とデジタル素材産業の動向」	岩間 公秀、中島 崇文.....	11
マーケットレポート「経済産業省『超長期エネルギー技術ビジョン』の概要と 電気機能材料の課題」.....	向山吉之、秋元智城.....	20
テクニカルレポート「電気機器」絶縁寿命診断技術の概要」.....	神谷 宏之.....	24
海外レポート「台湾のエナメル線用絶縁塗料市場」.....	王 端銘.....	30
コーヒープレイク「手打ちうどん・蕎麦」.....	後藤 卓郎.....	34
絶縁材料史(封止樹脂編)その3「エポキシ樹脂封止材の現在と 将来に向けた開発動向」.....	福井 太郎.....	35
用途から見た電気機能材料「自動車」.....	編集委員会.....	36
インパルス「経験を通して~見直される日本の技術」.....	佐々木 剛.....	48
会員会社紹介「株式会社岡部マイカ工業所」.....		49
官庁からのお知らせ「調査票提出促進運動について」.....	経済産業省.....	50
活動抄録「理事会」「業務部会」「運営委員会」「編集委員会」「技術部会」 「外部委員会等出席報告」「IEC関連情報」.....		51
関連情報紹介「ナノテク関連文献抄録」「文献抄録」 「官庁情報」「催物案内」「学会案内」.....		64
生産統計(平成18年6月~8月).....		72

*表紙デザイン:(書)向山 翠径